



KMT-1265 LED 有机硅灌封胶

特性

- 双组分加成型硅凝胶
- 高折射率
- 高透明度
- 离子含量低
- 模量低，应力小
- 极佳的粘接性
- 电性能优异
- 良好的光、热稳定性

产品性能

固化前

外观	无色透明液体
A 组分粘度	15000 mPa s
B 组分粘度	300 mPa s
混合粘度	1500 mPa s
折射率	1.54

产品应用

LED 等光电器件的封装

建议固化条件：150℃/1 小时或 100℃/2 小时

固化后

透光率（450nm/2mm）	>99%
钠离子含量	<2ppm
钾离子含量	<2ppm
氯离子含量	<2ppm
比重	1.14g/cm ³

- 以上数据在 25℃下测得，均为非规格值，使用材料前请进行试验，确认是否适合使用目的。
- 性能可以根据客户要求进行调整。

使用方法

将 A、B 两组分按重量比 1:1 混合均匀，室温下真空脱泡后使用。

若脱泡过程中气泡破裂困难，可采用多次急速恢复常压的方法促进气泡破裂。须待气泡完全脱净后再点胶。

使用期：混合后室温（25℃）下 8 小时



KMT-1265 LED 有机硅灌封胶

使用注意事项

固化阻碍（催化剂中毒）

有些材料、化合物、固化剂和增塑剂等，会阻碍加成型有机硅材料的固化，主要包括：

有机锡和其它有机金属合成物
含有机锡催化剂的硅橡胶
硫、聚硫化物、聚砜类物或其它含硫物品
胺、氨基甲酸乙酯或含胺物品
不饱和的碳氢增塑剂
某些助焊剂残余物

如果对某物质或材料是否会引起阻碍固化存有疑问，建议做小型测试试验，以确定在此应用中的适用性。

清洗

未固化的胶液可使用丙酮或二甲苯清洗，但水和乙醇达不到清洗效果。

储存

有机硅灌封胶应在通风的冷暗处存储（25℃以下，阳光不直射），采取预防措施，防止物料接触湿气。容器应保持密封，避免容器中只盛装很少的物料。部分盛装的容器应以干燥的空气或氮气充填。

保质期：6个月

包装

塑料瓶包装，500g/瓶
6Kg/箱